

S1C17 マニュアル 正誤表

項目 パッケージ			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S1C17653 テクニカルマニュアル	412355700	1.1 特長 表 1.1.1 特長 出荷形態 3	1-2
		24.2.2 金バンプ仕様	24-4
		Appendix C 実装上の注意事項 金バンプチップ品の取り扱い	AP-C-3
1-2 ページ、表 1.1.1 特長、出荷形態 3			
(誤)金バンプチップ (正)(本項目削除)			
24-4 ページ、24.2.2 金バンプ仕様			
(誤)24.2.2 金バンプ仕様 (正)(本項目削除)			
24.2.2 金バンプ仕様			
表24.2.2.1 金バンプ仕様			
特性項目		仕様	
バンプ形状		ストレートバンプ	
バンプ高さ (A配線上からバンプトップ までの距離)	中心値	17μm Typ.	
	全ロット, 全バンプバラツキ公差	中心値 ± 4μm	
	チップ内バラツキ公差	R (Max. - Min.) ≤ 3μm	
バンプ硬度	全ロット, 全バンプ	30~70HV	
バンプ強度	全ロット, 全バンプ	0.0067g/μm ² , 金バンプ内せん断	
バンプ表面凹凸	1/バンプ内, 高さMax. - Min.	3.0μm以下	
バンプ寸法	平面XY寸法公差(バンプトップ部)	X ± 4μm, Y ± 4μm	
バンプ~バンプ間隔	最小値	S = 20μm	

図24.2.2.1 金バンプ仕様

AP-C-3 Appendix C 実装上の注意事項 金バンプチップ品の取り扱い

(誤)金バンプチップ品の取り扱い (正)(本項目削除)

金バンプチップ品の取り扱い(ICへの高温ストレス印加について)

金バンプチップがCOF実装される場合など、ICに高温ストレスが印加されると、内蔵Flashメモリが特性変動を生じる場合があります。実装時などの熱条件(温度・時間)を下表で確認のうえ、「データ再プログラミング必要」の実装条件に該当する場合には対応のflsプログラムまたは単体フラッシュライターを使用してFlashメモリの再プログラミングを確実に実施してください。

なお、flsプログラムおよび単体フラッシュライターの詳細は各ツールマニュアルを参照してください。

温度	時間	Flashメモリへの影響なし	Flashメモリへの影響あり	
			データ再プログラミング必要	最大許容時間
~ 250°C		≤ 5時間	5時間 ~ 450時間	450時間
250°C ~ 300°C		≤ 400秒	400秒 ~ 10時間	10時間
300°C ~ 350°C		≤ 20秒	20秒 ~ 0.5時間	0.5時間
350°C ~ 400°C		≤ 1秒	1秒 ~ 100秒	100秒
400°C ~ 450°C		≤ 0.1秒	0.1秒 ~ 10秒	10秒
450°C ~				0秒

S1C17 マニュアル 正誤表

項目 パッケージ			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S1C17653 テクニカルマニュアル	412355700	表 1.1.1 特長 出荷形態1	1-2
		1.3.1 端子配置図	1-3
		1.3.2 端子説明	1-5
		24 パッケージ/チップ	24-1
S1C17656 テクニカルマニュアル	412745000	表 1.1.1 特長 出荷形態 2	1-2
		1.3.1 端子配置図	1-5
		1.3.2 端子説明	1-6
		24 パッケージ	24-1

S1C17653

1-2 ページ

(誤) TQFP14-80pin (14mm × 14mm × 1mm, 端子ピッチ: 0.5mm)

(正) QFP14-80pin (14mm × 14mm × 1.4mm, 端子ピッチ: 0.5mm)

1-3 ページ、1-5 ページ

(誤) TQFP14-80pin (正) QFP14-80pin (誤) TQFP (正) QFP

24-1 ページ

(誤)

24.1 TQFPパッケージ

TQFP14-80pinパッケージ

(単位: mm)

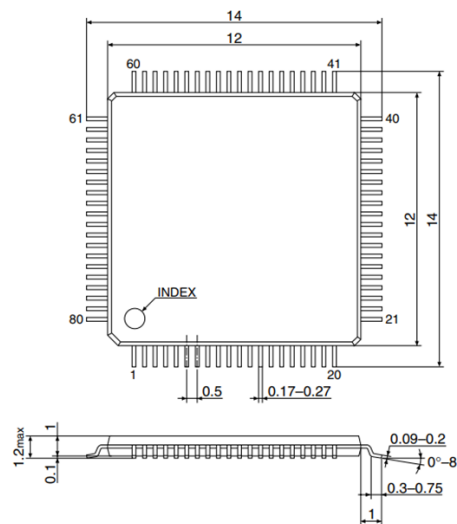


図24.1.1 TQFP14-80pinパッケージ寸法

(正)

24.1 QFPパッケージ

QFP14-80pinパッケージ

(単位: mm)

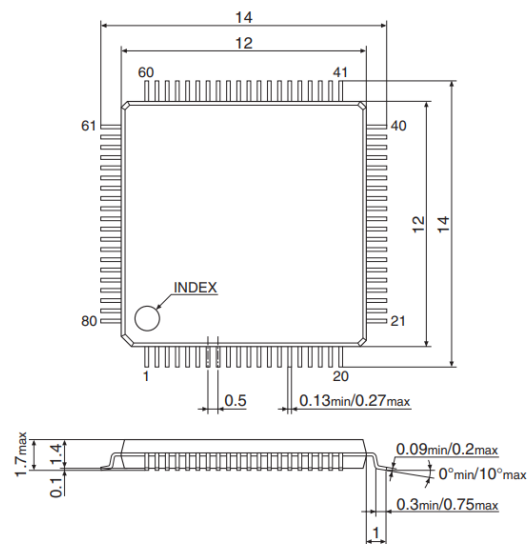


図24.1.1 QFP14-80pinパッケージ寸法

S1C17656

1-2 ページ

(誤) TQFP14-80pin (14mm × 14mm × 1mm, 端子ピッチ: 0.5mm)

(正) QFP14-80pin (14mm × 14mm × 1.4mm, 端子ピッチ: 0.5mm)

1-5 ページ、1-6 ページ

(誤) TQFP14-80pin (正) QFP14-80pin (誤) TQFP14-80 (正) QFP14-80

24-1 ページ

(誤)

24 パッケージ

TQFP14-80pin

(単位: mm)

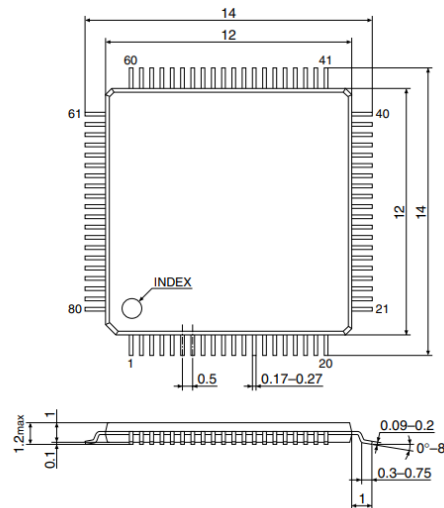


図24.1 TQFP14-80pin/パッケージ寸法

(正)

24 パッケージ

QFP14-80pin

(単位: mm)

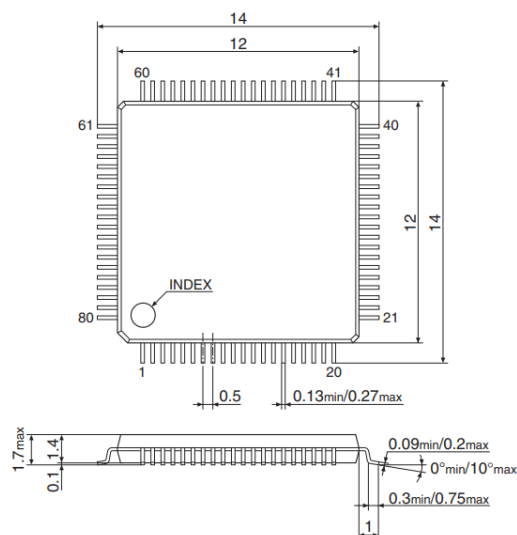


図24.1 QFP14-80pin/パッケージ寸法

S1C17 ファミリテクニカルマニュアル正誤表

項目 パッド/バンプ配置			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S1C17653 テクニカルマニュアル	412355700	29.2.1 パッド/バンプ配置	24-2
<p>(誤)</p> <p>チップサイズ X = 2.637mm, Y = 2.543mm</p> <p>パッド開口部 No. 1~17, 37~47: X = 76 μm, Y = 85 μm</p> <p>No. 18~36, 48~67: X = 85 μm, Y = 76 μm</p> <p>バンプサイズ No. 1~17, 37~47: X = 70 μm, Y = 79 μm</p> <p>No. 18~36, 48~67: X = 79 μm, Y = 70 μm</p> <p>チップ厚 400 μm</p>			
<p>(正)</p> <p>チップサイズ X = 2.637mm, Y = 2.543mm</p> <p>パッド開口部 No. 1~17, 37~47: X = 76 μm, Y = 85 μm</p> <p>No. 18~36, 48~67: X = 85 μm, Y = 76 μm</p> <p>バンプサイズ No. 1~17, 37~47: X = 70 μm, Y = 79 μm</p> <p>No. 18~36, 48~67: X = 79 μm, Y = 70 μm</p> <p>チップ厚 400 μm</p> <p>アライメントマーク座標: 左上(X:-1206.1um, Y:1159.1um) 右下(X:1206.1um, Y:-1095.1um)</p>			